

THE NEW VALUE FRONTIER



KTKF
다기능 가공용

GTP 브레이커

KTKF 다기능 가공용

GTP 브레이커

NEW



공정 집약으로 가공시간 단축과 비용 절감을 실현

홈·횡이송 가공을 집약하여 가공시간 단축
안정된 칩 처리, 우수한 정삭면 품위를 실현



KTKF 다기능 가공용

GTP 브레이커

홈·횡이송 가공을 집약
가공시간 단축



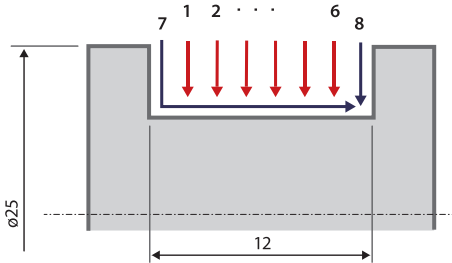
1

홈가공 + 횡이송가공으로
가공시간 단축과 비용 절감을 실현

가공시간 비교 (당사비교)

경쟁사 A

복수 홈가공 + 정삭가공
피삭재 : S45C(φ25)

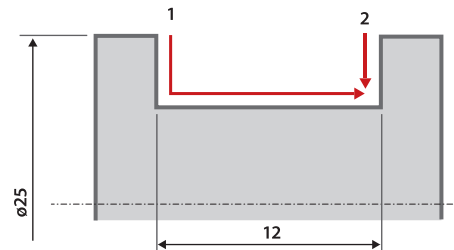


절삭조건(복수 홈가공)
Vc=100m/min
ap=3.5mm, f=0.10mm/rev

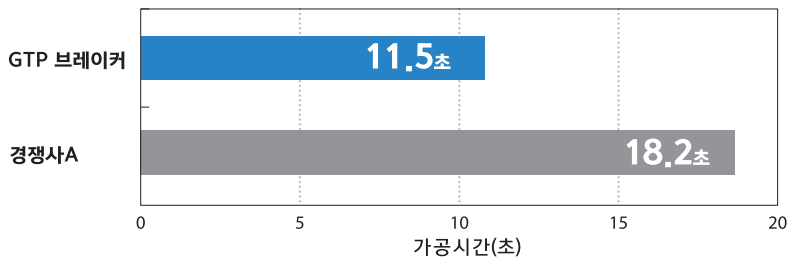
절삭조건(정삭가공)
Vc=100m/min
ap=0.5mm, f=0.05mm/rev

TKF12R200-GTP

홈가공 + 횡이송가공
피삭재 : S45C(φ25)



절삭조건(홈가공 + 횡이송가공)
Vc=100m/min
ap=4mm, f=0.05mm/rev



경쟁사의 가공에 비해서 가공 패스 감소

40%

가공시간 단축

Solution 공정 집약 이미지

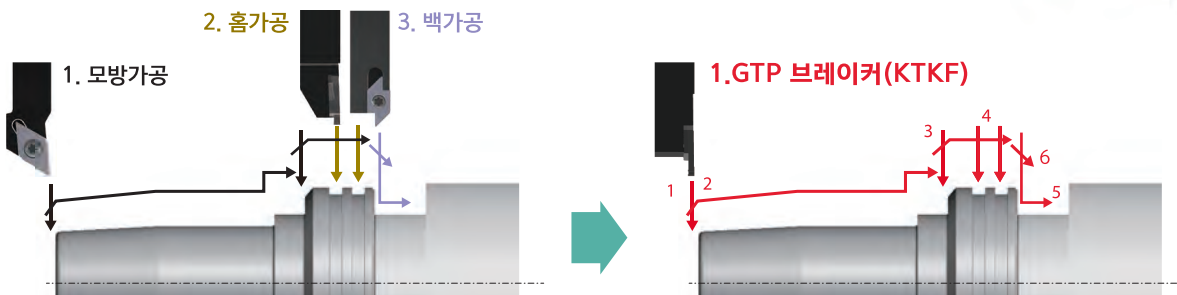
GTP브레이커에 의해 모방가공+홈가공+백가공의 3가지 공구를 1개로 집약 가능

기존 공구

GTP 브레이커(KTKF)



워크 형상



※ 홈폭, 최대 절입량을 주의하십시오.(홈/최대 절입량) TKF12R200-GTP(2.0mm/4.0mm), TKF16R300-GTP(3.0mm/5.5mm)

2

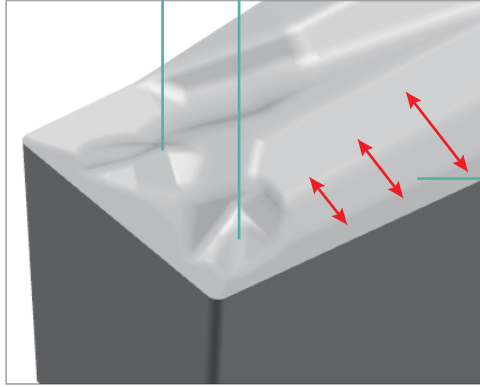
광범위한 가공 영역에서 안정된 칩처리, 우수한 정삭면 품질을 실현

브레이커의 특징

흡용 도트

가공 형태에 따른 도트를 설계하여
저이송영역에서도 칩처리 우수

형이송용 도트



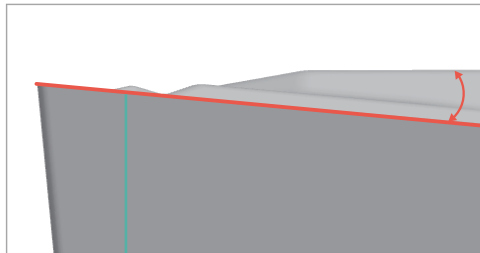
뒤 절삭날



앞 절삭날

브레이커 폭

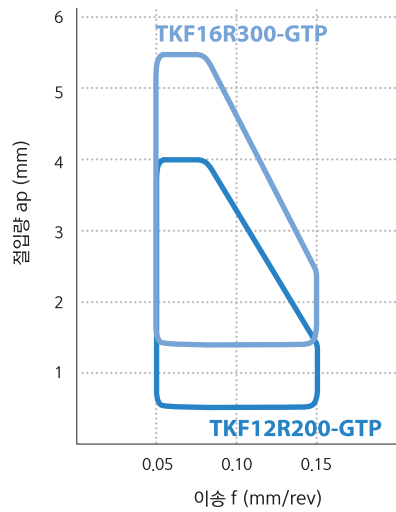
브레이커 폭을 절입량에 따라서 최적화
광범위한 가공영역에서 칩처리가 안정



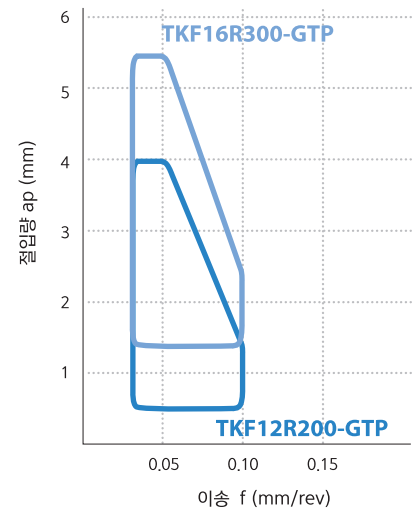
경사 절삭날

경사 절삭날에 의해 배분력을 감소
내떨림 성능 우수

브레이커 추천 영역(강)



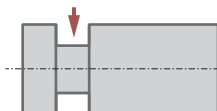
브레이커 추천 영역(SUS)



칩처리 비교 (당사비교) 흡가공

f (mm/rev)	0.05	0.07	0.10
TKF12R200-GTP			
경쟁사B			

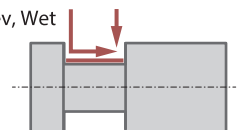
절삭조건 : $V_c=100\text{m/min}$, $a_p=4\text{mm}$, Wet
피삭재 : S45C($\phi 25$)



정삭면 품질 비교 (당사비교) 형이송가공

	TKF12R200-GTP	경쟁사 C
정삭면	 Rz= 3.21 μm	 Rz= 4.11 μm 뜯김

절삭조건 : $V_c=100\text{m/min}$, $a_p=4\text{mm}$, $f=0.05\text{mm/rev}$, Wet
피삭재 : S45C($\phi 25$)



GTP 브레이커는 경쟁사에 비해 칩처리가 우수하고 가공면도 우수

표준재고 규격

형상	규격	치수(mm)							각도	MEGACOAT NANO PLUS PR1725	MEGACOAT NANO PR1535	적합 홀더
		CW	CDX	RE	W1	S	D1	PSIRR				
	TKF12R200-GTP	2.0	4.3	0.08	3.0	8.7	5.0	0°	●	●	●	KTKFR...12
	TKF16R300-GTP	3.0	5.8	0.08	4.0	9.5	5.0	0°	●	●	●	KTKFR...16

·적합 홀더의 상세 내용은 [교세라 절삭공구 종합 카탈로그] 등을 참조하십시오.

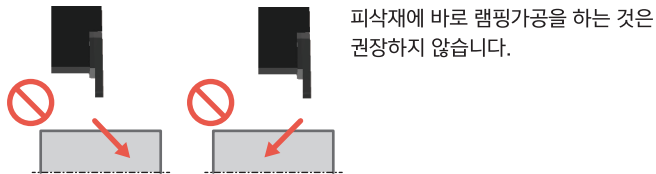
● : 표준재고

추천 절삭조건표 ★제1추천 ☆제2추천

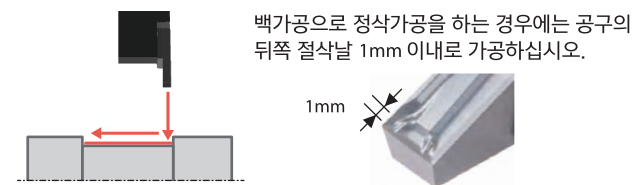
피삭재		추천 팁 재종			
		MEGACOAT NANO PLUS		MEGACOAT NANO	
		PR1725		PR1535	
		홈가공	횡이송	홈가공	횡이송
탄소강·합금강 (S45C, SCM435 등)	절삭속도 Vc (m/min)	★ 60 ~ 200		☆ 60 ~ 150	
	이송 f (mm/rev)	0.03 ~ 0.07	0.05 ~ 0.15	0.03 ~ 0.07	0.05 ~ 0.15
스테인리스강 (SUS304 등)	절삭속도 Vc (m/min)	☆ 60 ~ 150		★ 60 ~ 130	
	이송 f (mm/rev)	0.02 ~ 0.05	0.03 ~ 0.10	0.02 ~ 0.05	0.03 ~ 0.10

가공시의 주의점

램핑가공에 대해서

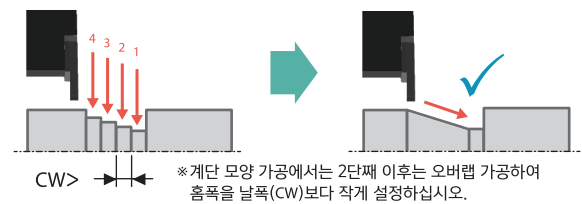


백가공에 대해서



램핑가공의 원포인트

계단 모양으로 홈 가공을 한 후에 램핑가공을 하십시오.(아래 그림 참조)



날폭



백 테이퍼가공은 권장하지 않습니다.



가공 사례

스몰 SCM415

GTP 브레이커

Vc=120m/min, ap=2.5mm
f=0.02mm/rev, Wet
TKF12R200-GTP (PR1535)

GTP 브레이커 (날폭 2mm)



칩 영킴이 없고 우수. 연속 가공 가능.

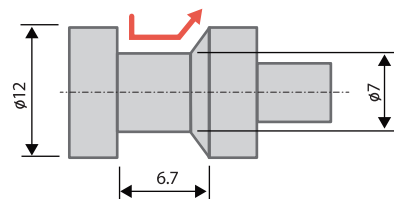
기존품 A

Vc=120m/min, ap=2.3mm(홈가공)
0.2mm(정삭가공)
f=0.02mm/rev, Wet

기존품 A (날폭 2mm)



횡이송(정삭) 가공시에, 공구에 칩의 영킴이 발생



GTP브레이커는 기존품에 비해서
가공 패스의 삭감, 칩처리 개선이 가능

(고객 평가)

「MEGACOAT NANO」는 교세라 주식회사의 등록상표입니다.

절삭공구에 관련한 문의사항은

한국교세라정공 영업기술팀 **032-899-1366**

FAX : 032-821-8369

●상담시간 8:30~12:00·13:00~16:30 ●토요일·일요일·공휴일 등은 쉽니다.

한국교세라정공(주)

영업본부

인천광역시 남동구 남동대로215번길 11(고잔동)
구) 인천광역시 남동구 고잔동 638-1, 남동공단 69BL 2LT
TEL:032-821-8365 FAX:032-821-8369
우:21633 http://www.kptk.co.kr